

檔 號：

保存年限：

教育部 函

機關地址：100217 臺北市中正區中山南路
5號

承辦人：蘇政君

電話：02-7736-6164

電子信箱：sumc@mail.moe.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國112年5月4日

發文字號：臺教技(三)字第1120045083號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

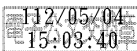
附件：智慧財產局函(附件一 A09000000E_1120045083_senddoc1_Attach1.PDF)

主旨：轉知經濟部智慧財產局辦理2023台灣創新技術博覽會
「發明競賽」徵展一案(如附件)，請查照。

說明：

- 一、依經濟部智慧財產局112年5月3日智國企字第11230004891號函辦理。
- 二、本展報名期間自112年4月28日至7月21日止，相關展覽訊息、參展說明及報名電子檔，請逕至本展報名網頁(<https://www.inventaipai.com.tw/zh-tw/menu/9F7FD125309115F0D0636733C6861689/info.html>)查詢及下載報名表格等相關資料。
- 三、如有相關疑問，請逕洽經濟部智慧財產局，電話：(02) 23766131。

正本：各公私立大專校院(和春技術學院、蘭陽技術學院除外)

副本：經濟部智慧財產局 



裝

訂

線

國立中興大學

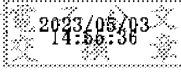
第1頁，共3頁
線上簽核文件列印 - 第2頁/共4頁



1120008469 112/05/04

https://www.inventaipai.com.tw/zh-tw/menu
 /9F7FD125309115F0D0636733C6861689/info.html) , 即可
 查詢及下載報名表格等相關資料。

正本：國家科學及技術委員會、教育部、行政院農業委員會
 副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會



裝



線

